

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 电话会议 ☐ 其他（）
参与单位名称	2026 年 7 月 16 日 Balyasny Asset Management、长信基金、诚通基金、华泰资产管理、交银施罗德、中欧基金等
时间	2026 年 7 月 16 日
调研方式	线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长、首席执行官、总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,700 多

	个数模混合 IP 和射频 IP。基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。 为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。 基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。 2020 年，公司在科创板上市时，曾被誉为“中国半导体 IP 第一股”；随着公司业务在 AI 芯片定制领域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AI ASIC 龙头企业”。
交流问答	问题：公司近期新签订单增长很快，主要由于哪些业务带动？ 回复：受益于 AI 产业高速发展，AI ASIC 市场需求快速增长。公司依托丰富的 AI 处理器 IP 组合和全面的 AI ASIC 定制服务能力，已迅速成为这一趋势的关键赋能者，实现近期新签订单快速增长。 2026 年 4 月 30 日，公司披露 2026 年 1 月 1 日至 4 月 29 日新签订单 82.40 亿元；延续前期新签订单的增长态势，公司最新披露 4 月 30 日至 7 月 16 日新签订单进一步增长，达到 64.13 亿元，其中 AI 算力相关订单及

	数据处理领域订单占比均超过 90%。自年初至 7 月 16 日，公司新签订单合计近 150 亿元，其中绝大部分为一站式芯片定制业务订单。 问题：请问公司量产业务主要和哪些晶圆厂合作，是否可以帮助客户保障产能？ 回复：公司采用晶圆厂中立策略，和全球主流晶圆厂保持紧密联系并长期合作，供应链管理灵活且抗风险能力强，具体主要表现在：芯原对晶圆厂中立的策略，使得芯原可以和全球所有主流的晶圆厂合作，不受限于某一家公司的发展情况；公司与大多数晶圆厂拥有超过 10 年或 15 年的长期合作关系，共同发展，保持了良好的沟通；在长期合作中，芯原建立了良好的商业信誉，供应商会按历史合作数据预留产能，保障供给；公司可以通过打包的方式拿到产能，有自己的资源池，通过内部资源再分配，对中小型规模的客户友好；不同生产工艺的产能短缺时间和程度不一样，因芯原客户多样化，可以做一定的调整 and 平衡。 问题：请问公司在先进封装领域有哪些布局？ 回复：为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，公司正在搭建覆盖多种新一代封装技术的设计能力。在持续支持 CoWoS 等现有方案的同时，公司前瞻性布局了面板级封装技术（Panel-Level Packaging, PLP）。PLP 采用大型矩形面板替代圆形晶圆，在生产输出和成本方面具备潜在优势，其散热和可靠性特征高度契合汽车电子等高规格应用的需求。未来，公司将积极推动新一代封装技术与芯片设计的协同，为客户提供极具成本效益且保障供应的芯片定制解决方案服务。
--	--